



*a Leiterplattenlayout
printed circuit board layout
modèle de la carte imprimée

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2411 03	4	100

Verpackung: im Tablett
Packaging: in tray
Emballage: en tableau

2411 03

USB-2.0-Einbaukupplung Typ B, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

- 1. Temperaturbereich** -40 °C/+85 °C
- 2. Werkstoffe**

Kontaktträger	PBT
Kontaktfeder	CuSn
Lötanschluss	CuSn
Gehäuse	CuZn/Stahl
- 3. Mechanische Daten**

Steckkraft	≤ 35 N
Ziehkraft	≥ 10 N
Kontaktierung mit	USB-Stecker 2431
- 4. Elektrische Daten**

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	≤ 1 A
Bemessungsspannung	30 V AC (RMS)
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

2411 03

USB 2.0 chassis socket type B, angular version, for printed circuit boards

- 1. Temperature range** -40 °C/+85 °C
- 2. Materials**

Insulating body	PBT
Contact spring	CuSn
Solder pin	CuSn
Shell	CuZn/steel
- 3. Mechanical data**

Insertion force	≤ 35 N
Withdrawal force	≥ 10 N
Mating with	USB plug 2431
- 4. Electrical data**

Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	≤ 1 A
Rated voltage	30 V AC (RMS)
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

2411 03

Embase femelle USB 2.0 type B, version angulaire, pour cartes imprimées

- 1. Température d'utilisation** -40 °C/+85 °C
- 2. Matériaux**

Corps isolant	PBT
Ressort de contact	CuSn
Plot à souder	CuSn
Boîtier	CuZn/acier
- 3. Caractéristiques mécaniques**

Force d'insertion	≤ 35 N
Force de séparation	≥ 10 N
Raccordement avec	connecteur mâle USB 2431
- 4. Caractéristiques électriques**

Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	≤ 1 A
Tension assignée	30 V AC (RMS)
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ